

ウィスカ（whisker）とは、金属表面に金属単結晶がヒゲ状に自然成長する現象のことで、おもに錫（Sn）メッキや亜鉛（Zn）メッキなどから発生します。ウィスカにより隣接する配線がショートすると、電機製品や電子回路、電子デバイスなどの故障原因となります。

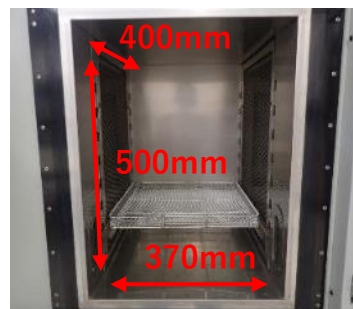
JTLでは、試験体に冷熱衝撃試験や恒温恒湿試験を実施し、ウィスカ発生の有無の評価が可能です。

## 冷熱衝撃試験

試験体に高温⇔低温の熱衝撃を繰り返し与え、ウィスカの発生を促進します。

- 装置スペック  
高温側：60～200℃  
低温側：-65～0℃

〈 槽内サイズ 〉



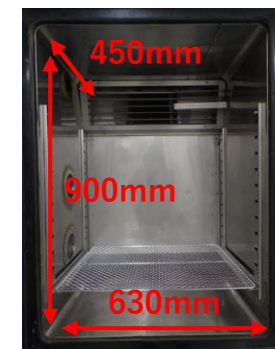
※籠は340mm×330mm、  
Max7段設置可能

## 恒温恒湿試験

試験体に温度・湿度両方の変化を与え、ウィスカの発生を促進します。

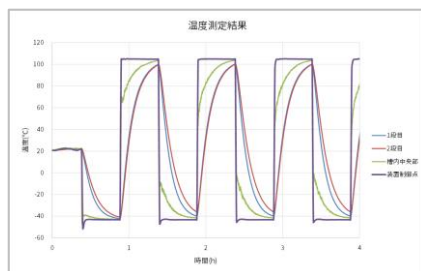
- 装置スペック  
温度範囲：-70～180℃  
湿度範囲：20～98%RH

〈 槽内サイズ 〉



※棚板は600mm×500mm、  
Max10段設置可能

## 試験結果



〈 温度プロファイル 〉



〈 ウィスカ観察画像 〉

### ▼ お問い合わせ先はこちら

評価技術に関するご質問・ご相談はWebのお問い合わせフォームまで

<https://jtl.co.jp/contact/01/>